

VIA propose des modules processeur adaptés aux besoins des industriels

Au fil des ans, **VIA Technologies** a réduit le format de ses cartes mères : **Mini-ITX** (17 x 17 cm), **Nano-ITX** (12 x 12 cm) puis **Pico-ITX** (10 x 7,2 cm). La compagnie propose maintenant une nouvelle offre, [le Mobile-ITX](#), d'une taille record de **6 x 6 cm**.

Les modules Mobile-ITX sont destinés à **prendre place sur une carte de plus grandes dimensions**, un concept assez commun dans le monde industriel. Ils comprennent toute la connectique nécessaire. De plus, ils adoptent un processeur refroidi passivement. La consommation des modules Mobile-ITX devrait être comprise **entre 4,5 W et 12 W**.

« Avec le Mobile-ITX nous repoussons encore les limites de taille des PC industriels », déclare **Daniel Wu**, vice-président *VIA embedded platform division*. « Ce format permettra la création de produits connectés ultracompacts, adaptés à une large gamme d'applications, notamment dans les secteurs de la médecine et de la défense. »

[La documentation officielle](#) fournie par VIA fait état **d'une première carte de référence**, qui devrait être disponible au cours du premier trimestre 2010. Elle s'architecturera autour d'un processeur **VIA C7-M ULV** (dont la fréquence de fonctionnement n'est pas précisée) et du jeu de circuits **VIA VX820**. Moderne, ce dernier intègre une solution graphique à mémoire partagée **VIA Chrome9 HC3**. Le tout sera épaulé par **512 Mo de DDR2**, soudés directement sur le module.

Voilà de quoi satisfaire les industriels, même si certains regretteront que la compagnie fasse – encore une fois – l'impasse sur le processeur **VIA Nano**, bien plus performant et efficace que le vieillissant C7.

